|  |
| --- |
| [2023-2029年中国挠性覆铜板行业深度调研与发展趋势预测](https://www.20087.com/8/71/NaoXingFuTongBanHangYeQuShiFenXi.html) |



#### [中国市场调研网](https://www.20087.com/)

[www.20087.com](https://www.20087.com/)

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | [2023-2029年中国挠性覆铜板行业深度调研与发展趋势预测](https://www.20087.com/8/71/NaoXingFuTongBanHangYeQuShiFenXi.html) |
| 报告编号： | 2628718　　←电话咨询时，请说明该编号。 |
| 市场价： | 电子版：8500 元　　纸介＋电子版：8800 元 |
| 优惠价： | 电子版：7600 元　　纸介＋电子版：7900 元　　可提供增值税专用发票 |
| 咨询电话： | 400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099 |
| Email： | Kf@20087.com |
| 在线阅读： | [<https://www.20087.com/8/71/NaoXingFuTongBanHangYeQuShiFenXi.html>](https://www.20087.com/2/95/ZhiNengXiWanJiShiChangQianJingYuCe.html) |
| 温馨提示： | 订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。 |

二、内容简介

　　挠性覆铜板是一种用于制造柔性电路板的关键材料，近年来随着电子产品向轻薄化、便携化方向发展而得到了广泛应用。目前，挠性覆铜板行业呈现出以下几个特点：首先，随着对挠性覆铜板性能要求的提高，材料技术不断创新，如采用更薄、更柔韧的基材。其次，随着电子产品多样性的增加，挠性覆铜板的设计更加灵活，能够适应不同形状和尺寸的需求。此外，随着5G通信技术的发展，挠性覆铜板的高频性能也得到了重视，如开发具有更低介电常数和损耗角正切值的产品。
　　未来，挠性覆铜板行业的发展将更加注重技术创新和高性能。一方面，随着新材料技术的发展，挠性覆铜板将更加注重提高材料性能，如开发具有更高耐热性、更好导电性的新型材料。另一方面，随着5G通信和物联网技术的应用，挠性覆铜板将更加注重高频性能，以适应高速数据传输的需求。此外，随着对环保要求的提高，挠性覆铜板的生产将更加注重环保性能，如采用可回收材料、减少有害物质的使用。
　　《[2023-2029年中国挠性覆铜板行业深度调研与发展趋势预测](https://www.20087.com/8/71/NaoXingFuTongBanHangYeQuShiFenXi.html)》深入剖析了当前挠性覆铜板行业的现状与市场需求，详细探讨了挠性覆铜板市场规模及其价格动态。挠性覆铜板报告从产业链角度出发，分析了上下游的影响因素，并进一步细分市场，对挠性覆铜板各细分领域的具体情况进行探讨。挠性覆铜板报告还根据现有数据，对挠性覆铜板市场前景及发展趋势进行了科学预测，揭示了行业内重点企业的竞争格局，评估了品牌影响力和市场集中度，同时指出了挠性覆铜板行业面临的风险与机遇。挠性覆铜板报告旨在为投资者和经营者提供决策参考，内容权威、客观，是行业内的重要参考资料。

第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求
　　第一节 按不同基材分类的FCCL品种
　　第二节 按不同构成分类的FCCL品种
　　第三节 按不同应用领域分类的FCCL品种
　　第四节 FCCL品种的其它分类
　　第五节 产品主要采用的标准及性能要求
　　　　一、FCCL管理体制
　　　　二、FCCL相关标准
　　　　三、FCCL的主要性能要求

第二章 挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究
　　第一节 三层型FCCL的制造工艺法及其特点
　　　　一、片状制造法
　　　　二、卷状制造法
　　第二节 二层型FCCL的制造工艺法及其特点
　　　　一、涂布法
　　　　二、溅射 电镀法
　　　　三、层压法
　　　　四、三种工艺法生产的L-FCCL在性能、工艺特点方面的比较
　　第三节 近年FPC的技术发展方面
　　　　一、二层型FCCL已成品种发展的主流
　　　　二、FCCL近年在技术方面的进步

第三章 2018-2023年世界挠性覆铜板市场现状分析
　　第一节 2018-2023年世界挠性覆铜板产业发展概述
　　　　一、世界挠性覆铜板产业发展概述
　　　　二、世界FCCL市场规模及结构
　　　　三、世界挠性覆铜板价格竞争分析
　　　　四、FCCL原材料形态结构发生变化
　　第二节 2018-2023年世界挠性覆铜板区域市场评估
　　　　一、美国
　　　　二、日本
　　　　三、欧洲
　　　　四、韩国
　　　　五、中国台湾
　　第三节 2023-2029年世界挠性覆铜板产业趋势预测分析

第四章 2018-2023年世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析
　　第一节 新日铁化学株式会社
　　　　一、公司基本概况
　　　　二、公司经营与销售状况分析
　　　　三、公司竞争优势分析
　　第二节 宇部兴产株式会社
　　　　一、公司基本概况
　　　　二、公司经营与销售状况分析
　　　　三、公司竞争优势分析
　　第三节 中国台湾律胜科技股份有限公司
　　　　一、公司基本概况
　　　　二、公司经营与销售情况分析
　　　　三、公司竞争优势分析
　　第四节 新扬科技股份有限公司
　　　　一、公司基本概况
　　　　二、公司经营与销售分析
　　　　三、公司竞争优势分析
　　第五节 亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司
　　　　一、公司基本概况
　　　　二、公司经营与销售情况分析
　　　　三、公司竞争优势分析
　　　　四、公司国际化战略发展
　　第六节 旗胜科技股份有限公司
　　　　一、公司基本概况
　　　　二、公司经营与销售情况分析
　　　　三、公司竞争优势分析
　　第七节 东丽世韩有限公司
　　　　一、公司发展基本概况
　　　　二、公司经营策略分析
　　第八节 SD电线有限公司

第五章 2018-2023年中国挠性覆铜板产业现状分析
　　第一节 2018-2023年中国覆铜板产业发展总体概述
　　　　一、中国覆铜板主要产品概述
　　　　二、中国覆铜板生产发展历程
　　　　三、中国覆铜板生产发展现状调研
　　　　四、中国覆铜板全面调研
　　　　五、中国覆铜板技改科研成果
　　第二节 2018-2023年中国挠性覆铜板产业发概况
　　　　一、中国挠性覆铜板产业发概况
　　　　二、中国挠性覆铜板生产情况分析
　　　　三、中国挠性覆铜板的产能与产量
　　　　四、中国挠性覆铜板企业销售情况分析
　　第三节 2018-2023年挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析

第六章 2018-2023年中国挠性覆铜板相关市场发展现状分析
　　第一节 2018-2023年中国挠性印制电路业发展分析
　　　　一、柔性电路板相关概述
　　　　二、世界FPC产值及生产企业
　　　　三、我国FPC生产企业的现状调研
　　　　四、FPC多层挠性板的新技术
　　　　五、重庆彭水建柔性线路板基地
　　第二节 二层型挠性覆铜板在LCD的IC驱动用COF市场现状与发展
　　　　一、驱动IC用COF
　　　　二、驱动IC用COF挠性基板的性能特点及市场发展
　　　　三、COF挠性基板生产现状调研

第七章 2018-2023年中国印制电路板制造所属行业经济运行情况分析
　　第一节 2018-2023年中国印制电路板制造所属行业调研
　　　　一、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业发展概况
　　第二节 2018-2023年中国印制电路板制造所属行业总体规模分析
　　　　一、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业企业规模分析
　　　　二、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业人员规模统计
　　　　三、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业资产规模分析
　　　　四、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业负债规模分析
　　　　五、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业市场规模分析
　　第三节 2018-2023年中国印制电路板制造所属行业供需平衡分析
　　　　一、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业产成品分析
　　　　二、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业供给区域分布
　　　　三、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业销售产值分析
　　　　四、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业需求区域分布
　　第四节 2018-2023年中国印制电路板制造所属行业投资状况分析
　　　　一、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业投资增长分析
　　　　二、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业投资区域分布
　　　　三、2018-2023年不同规模印制电路板制造所属企业资产总额分析
　　　　四、2018-2023年不同性质印制电路板制造所属企业资产总额分析
　　第五节 2018-2023年中国印制电路板制造所属行业获利能力分析
　　　　一、2018-2023年中国印制电路板制造所属行业利润总额分析
　　　　二、2018-2023年不同规模印制电路板制造企业获利能力分析
　　　　三、2018-2023年不同性质印制电路板制造企业获利能力分析
　　　　四、2018-2023年中国主要省区印制电路板制造行业获利能力
　　第六节 2018-2023年中国印制电路板制造行业经营效益分析
　　　　一、2018-2023年印制电路板制造所属行业偿债能力分析
　　　　二、2018-2023年印制电路板制造所属行业盈利能力分析
　　　　三、2018-2023年印制电路板制造所属行业毛利率分析
　　　　四、2018-2023年印制电路板制造所属行业运营能力分析
　　第七节 2018-2023年中国印制电路板制造所属行业成本费用分析
　　　　一、2018-2023年印制电路板制造所属行业销售成本分析
　　　　二、2018-2023年印制电路板制造所属行业销售费用分析
　　　　三、2018-2023年印制电路板制造所属行业管理费用分析
　　　　四、2018-2023年印制电路板制造所属行业财务费用分析
　　第八节 2018-2023年中国印制电路板制造所属行业总体结构特征分析
　　　　一、2018-2023年印制电路板制造所属行业经济类型结构
　　　　二、2018-2023年印制电路板制造企业规模结构分析
　　　　三、2018-2023年印制电路板制造所属行业区域结构特征
　　第九节 2018-2023年中国印制电路板制造行业集中度分析
　　　　一、行业资产集中度分析
　　　　二、行业销售集中度分析
　　　　三、行业利润集中度分析

第八章 2018-2023年中国覆铜板及铜箔进出口数据监测分析
　　第一节 2018-2023年中国覆铜板及铜箔进口数据分析
　　　　一、2018-2023年中国覆铜板及铜箔进口数量状况分析
　　　　二、2018-2023年中国覆铜板及铜箔进口金额状况分析
　　第二节 2018-2023年中国覆铜板及铜箔出口数据分析
　　　　一、2018-2023年中国覆铜板及铜箔出口数量状况分析
　　　　二、2018-2023年中国覆铜板及铜箔出口金额状况分析
　　第三节 2018-2023年中国覆铜板及铜箔进出口均价分析
　　第四节 2018-2023年中国覆铜板及铜箔进出口国家及地区分析
　　　　一、2018-2023年中国覆铜板及铜箔进口国家及地区分析
　　　　二、2018-2023年中国覆铜板及铜箔出口国家及地区分析
　　第五节 2018-2023年中国覆铜板及铜箔进出口省市分析
　　　　一、2018-2023年中国覆铜板及铜箔进口省市状况分析
　　　　二、2018-2023年中国覆铜板及铜箔出口省市状况分析

第九章 2018-2023年中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析
　　第一节 广东生益科技股份有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业经营情况分析
　　　　三、企业经济指标分析
　　　　四、企业盈利能力分析
　　第二节 金宝电子（中国）有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业偿债能力分析
　　　　四、企业盈利能力分析
　　第三节 金安国纪科技股份有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业偿债能力分析
　　　　四、企业盈利能力分析
　　第四节 陕西生益科技有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业偿债能力分析
　　　　四、企业盈利能力分析
　　第五节 山东金宝电子股份有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业偿债能力分析
　　　　四、企业盈利能力分析
　　第六节 无锡宏仁电子材料科技有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业偿债能力分析
　　　　四、企业盈利能力分析
　　第七节 建滔积层板（韶关）有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业偿债能力分析
　　　　四、企业盈利能力分析
　　第八节 建滔积层板深圳有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业偿债能力分析
　　　　四、企业盈利能力分析
　　第九节 江门建滔积层板有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业偿债能力分析
　　　　四、企业盈利能力分析
　　第十节 苏州松下电工有限公司
　　　　一、公司基本状况分析
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业偿债能力分析
　　　　四、企业盈利能力分析

第十章 2018-2023年中国印刷电路板市场运行分析
　　第一节 2018-2023年中国印刷电路板行业发展概况
　　　　一、印刷电路板（PCB）分类及产业链
　　　　二、中国印刷电路板产量居世界首位
　　　　三、国内印刷线路板企业区域分布状况分析
　　　　四、印刷电路板技术发展水平及趋势预测分析
　　　　五、我国武汉将成为世界最大产业基地
　　　　六、中国台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群
　　　　七、重庆打造高技术印刷电路板产业高地
　　第二节 2018-2023年中国印刷电路板市场发展分析
　　　　一、2018-2023年中国印刷电路板产值规模
　　　　二、2018-2023年中国印刷电路板产品结构
　　　　三、中国印刷线路板市场集中度分析
　　　　四、中国印刷电路板市场需求特点分析
　　第三节 2018-2023年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析
　　　　一、国内PCB配套产业还需进一步完善
　　　　二、产品集中于中低端成本转嫁能力弱
　　　　三、企业基础技术研究与开发水平薄弱
　　　　四、行业无序竞争产品定价能力有限
　　　　五、PCB企业环保投入需进一步加强
　　第四节 2018-2023年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章 2018-2023年中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析
　　第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--PI薄膜
　　　　一、绝缘基膜的生产方式
　　　　二、FCCL发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求
　　　　三、世界FCCL用PI薄膜在品种和性能上的发展
　　　　四、世界挠性覆铜板用PI薄膜的市场需求状况分析
　　第二节 挠性覆铜板用导电材料
　　　　一、各类铜箔的品种及特征
　　　　二、压延铜箔
　　　　三、电解铜箔
　　　　四、FCCL发展对铜箔性能提出更高的要求
　　第三节 挠性覆铜板用胶粘剂
　　　　一、FPC用胶粘剂发展概述
　　　　二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的情况分析
　　　　三、环氧树脂粘合剂研究与应用的情况分析
　　　　四、聚xi亚胺粘合剂研究与应用的情况分析
　　　　五、世界FPC及FCCL用胶粘剂的主要生产厂家及品种
　　第四节 挠性覆铜板用覆盖膜

第十二章 2023-2029年中国挠性覆铜板行业趋势预测分析
　　第一节 2023-2029年中国挠性覆铜板行业发展趋势预测
　　　　一、印刷电路板行业预测分析
　　　　二、对未来FPC技术发展预测分析
　　　　三、FPC发展对FCCL提出更高性能的要求
　　第二节 2023-2029年中国挠性覆铜板行业市场预测分析
　　　　一、覆铜板生产供给预测分析
　　　　二、挠性覆铜板供给预测分析
　　　　三、挠性覆铜板市场发展现状分析
　　第三节 2023-2029年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测分析

第十三章 2023-2029年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析
　　第一节 2023-2029年中国挠性覆铜板行业投资环境分析
　　第二节 2023-2029年挠性覆铜板行业投资机会分析
　　　　一、中国覆铜板行业投资情况分析
　　　　二、挠性覆铜板区域投资机会分析
　　　　三、挠性覆铜板行业投资吸引力分析
　　第三节 2023-2029年中国挠性覆铜板行业前景调研分析
　　　　一、宏观经济风险
　　　　二、市场竞争风险
　　　　三、原材料市场风险
　　　　四、技术研发风险分析
　　第四节 中智-林-　2023-2029年中国挠性覆铜板行业投资前景预测

图表目录
　　图表 挠性聚xi亚胺覆铜板的型号和特性
　　图表 LPI-F、LPI-、LPI-F、LPI- 型产品性能要求
　　图表 LPI-F、LPI-F、LPI-F 型产品性能要求
　　图表 采用卷状涂布工艺法制L-FCCL的工艺过程图
　　图表 涂布法二层型FCCL的产品构成
　　图表 涂布法二层型FCCL的生产过程示意图
　　图表 层压法工艺制程
　　图表 层压生产线
　　图表 三种L-FCCL的工艺加工特点及剖面结构图
　　图表 三种L-FCCL制作方式的比较
略……

了解《[2023-2029年中国挠性覆铜板行业深度调研与发展趋势预测](https://www.20087.com/8/71/NaoXingFuTongBanHangYeQuShiFenXi.html)》，报告编号：2628718，

请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，

Email邮箱：Kf@20087.com

详细介绍：<https://www.20087.com/8/71/NaoXingFuTongBanHangYeQuShiFenXi.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！